

## 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

REC'D 17 FEB 2005

WIPO

PCT

出願人代理人

高田 守

様

あて名

〒 160-0007

東京都新宿区荒木町20番地 インテック88ビル  
5階 特許業務法人 高田・高橋国際特許事務所

PCT

国際調査機関の見解書  
（法施行規則第40条の2）  
〔PCT規則43の2.1〕発送日  
（日.月.年）

15. 2. 2005

出願人又は代理人  
の書類記号

R00230WO01

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/JP2005/000235

国際出願日

（日.月.年）

12. 01. 2005

優先日

（日.月.年）

22. 01. 2004

国際特許分類（IPC）Int.Cl<sup>1</sup> H01L23/12

出願人（氏名又は名称）

株式会社ルネサステクノロジ

## 1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎  
☐ 第II欄 優先権  
☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成  
☒ 第IV欄 発明の単一性の欠如  
☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  
☐ 第VI欄 ある種の引用文献  
☐ 第VII欄 国際出願の不備  
☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

## 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

## 3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

01. 02. 2005

名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/JP）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）  
坂本 薫昭

4R

9265

電話番号 03-3581-1101 内線 6363

様式PCT/ISA/237（表紙）（2004年1月）

## 第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表  
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面  
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる  
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された  
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

## 第IV欄 発明の単一性の欠如

1. 追加手数料納付の求め（様式PCT/ISA/206）に対して、出願人は、

- ☐ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☐ 追加手数料の納付はなかった。

2. ☒ 国際調査機関は、発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際調査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- ☐ 満足する。
- ☒ 以下の理由により満足しない。

この国際出願は発明の単一性の要件を満たさない4つの発明を含む。

主発明：「クレーム1-10, 13, 16-17」

第2発明：「クレーム11, 19」

第3発明：「クレーム12」

第4発明：「クレーム14-15」

第5発明：「クレーム18」

請求の範囲1を「最初に記載されている発明」として調査を行った結果、主発明の技術的特徴は、先行技術として、JP 2002-40095 A(日本電気株式会社)2002.02.06、JP 5-259306 A(富士通株式会社)1993.10.08、JP 11-17058 A(日本電気株式会社)1999.01.22に開示されているから新規でないことが明らかとなった。したがって、主発明の技術的特徴は、PCT規則13.2の第2文の意味において「特別な技術的特徴」とは認められない。

請求の範囲11, 19（第2発明）と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第2発明の「特別な技術的特徴」は、封止部材から露出するスペーサーである。

請求の範囲12（第3発明）と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第3発明の「特別な技術的特徴」は、配線の一部を封止部材の表面に露出させた構造である。

請求の範囲14-15（第4発明）と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第4発明の「特別な技術的特徴」は、封止部材の厚みを周辺部で薄くする構造である。

請求の範囲18（第5発明）と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第5発明の「特別な技術的特徴」は、基板上に主半導体装置を配置し、主半導体装置上に半導体パッケージを配置した構造である。

これら第2-5発明の間に一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係が存在するとは認められない。

なお、請求の範囲2-10, 13, 16-17は、請求の範囲1に周知技術を付加したにすぎないため、請求の範囲1と同じ発明区分とした。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。

☒ すべての部分

☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_

に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 3, 7, 10-12, 14-16, 18-19	有 無
	請求の範囲 1-2, 4-6, 8-9, 13, 17	
進歩性 (IS)	請求の範囲	有 無
	請求の範囲 1-19	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-19	有 無
	請求の範囲	

## 2. 文献及び説明

文献1: JP 2002-40095 A(日本電気株式会社)2002. 02. 06  
2: JP 5-259306 A(富士通株式会社)1993. 10. 08  
3: JP 11-17058 A(日本電気株式会社)1999. 01. 22  
4: JP 2003-224234 A(京セラ株式会社)2003. 08. 08  
5: JP 9-181254 A(富士通テン株式会社)1997. 07. 11  
6: JP 2000-323623 A(三菱電機株式会社)2000. 11. 24  
7: JP 2003-273317 A(NECエレクトロニクス株式会社)2003. 09. 26

請求の範囲1-2, 4-6, 8-9, 13, 17に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性を有しない。請求の範囲1-2, 4-6, 8-9, 13, 17に記載された発明は、文献1に開示されている。

請求の範囲1-2, 4-6, 8-9に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献2から新規性を有しない。請求の範囲1-2, 4-6, 8-9に記載された発明は、文献2に開示されている。

請求の範囲1-2, 4, 9に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献3から新規性を有しない。請求の範囲1-2, 4, 9に記載された発明は、文献3に開示されている。

請求の範囲3, 7, 10, 16に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1より進歩性を有しない。搭載基板に端子を二組以上設けることは周知技術である。また、外部接続用端子とテスト用端子の配置は、単なる設計事項である。そして、半導体チップを二つ以上積層することは、普通に行われている。さらに、封止部材により基板の外縁端部を包み込むように形成することは、慣用手段にすぎない。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V 欄の続き

請求の範囲11, 19に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1, 4より進歩性を有しない。スペーサーを配置することは、文献4に記載されている。

請求の範囲12に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1, 5より進歩性を有しない。配線の一部を封止部材の表面に露出させることは、文献5に記載されている。

請求の範囲14-15に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1, 6より進歩性を有しない。外部接続用端子の配置領域に対応する封止部材を相対的に小さな厚みとすることは、文献6に記載されている。また、該領域を外周部とすることは、単なる設計事項にすぎない。

請求の範囲18に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1, 7より進歩性を有しない。主基板に表面に主半導体を配置して、主半導体の表面に半導体パッケージを配置することは、文献7に記載されている。



## 特許協力条約

発行人 日本国特許庁（国際調査機関）

REC'D 17 FEB 2005

WIPO

PCT

出願人代理人

高田 守

様

あて名

〒 160-0007

東京都新宿区荒木町20番地 インテック88ビル  
5階 特許業務法人 高田・高橋国際特許事務所

PCT

国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
[PCT規則43の2.1]発送日  
(日.月.年)

15. 2. 2005

出願人又は代理人  
の書類記号

R00230WO01

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/JP2005/000235

国際出願日

(日.月.年)

12. 01. 2005

優先日

(日.月.年)

22. 01. 2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl<sup>1</sup> H01L23/12

出願人 (氏名又は名称)

株式会社ルネサステクノロジ

## 1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎  
☐ 第II欄 優先権  
☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成  
☒ 第IV欄 発明の単一性の欠如  
☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  
☐ 第VI欄 ある種の引用文献  
☐ 第VII欄 国際出願の不備  
☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

## 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

## 3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

01. 02. 2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)  
坂本 薫昭

4R

9265

電話番号 03-3581-1101 内線 6363

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

## 第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表  
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面  
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる  
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された  
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

## 第IV欄 発明の単一性の欠如

1. 追加手数料納付の求め（様式PCT/ISA/206）に対して、出願人は、

- ☐ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☐ 追加手数料の納付はなかった。

2. ☒ 国際調査機関は、発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際調査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- ☐ 満足する。
- ☒ 以下の理由により満足しない。

この国際出願は発明の単一性の要件を満たさない4つの発明を含む。

主発明：「クレーム1-10, 13, 16-17」

第2発明：「クレーム11, 19」

第3発明：「クレーム12」

第4発明：「クレーム14-15」

第5発明：「クレーム18」

請求の範囲1を「最初に記載されている発明」として調査を行った結果、主発明の技術的特徴は、先行技術として、JP 2002-40095 A(日本電気株式会社)2002.02.06、JP 5-259306 A(富士通株式会社)1993.10.08、JP 11-17058 A(日本電気株式会社)1999.01.22に開示されているから新規でないことが明らかとなった。したがって、主発明の技術的特徴は、PCT規則13.2の第2文の意味において「特別な技術的特徴」とは認められない。

請求の範囲11, 19（第2発明）と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第2発明の「特別な技術的特徴」は、封止部材から露出するスペーサーである。

請求の範囲12（第3発明）と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第3発明の「特別な技術的特徴」は、配線の一部を封止部材の表面に露出させた構造である。

請求の範囲14-15（第4発明）と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第4発明の「特別な技術的特徴」は、封止部材の厚みを周辺部で薄くする構造である。

請求の範囲18（第5発明）と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第5発明の「特別な技術的特徴」は、基板上に主半導体装置を配置し、主半導体装置上に半導体パッケージを配置した構造である。

これら第2-5発明の間に一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係が存在するとは認められない。

なお、請求の範囲2-10, 13, 16-17は、請求の範囲1に周知技術を付加したにすぎないため、請求の範囲1と同じ発明区分とした。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。

☒ すべての部分

☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_

に関する部分



## 第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 3, 7, 10-12, 14-16, 18-19	有
	請求の範囲 1-2, 4-6, 8-9, 13, 17	無
進歩性 (IS)	請求の範囲	有
	請求の範囲 1-19	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-19	有
	請求の範囲	無

## 2. 文献及び説明

文献1: JP 2002-40095 A(日本電気株式会社)2002.02.06  
2: JP 5-259306 A(富士通株式会社)1993.10.08  
3: JP 11-17058 A(日本電気株式会社)1999.01.22  
4: JP 2003-224234 A(京セラ株式会社)2003.08.08  
5: JP 9-181254 A(富士通テン株式会社)1997.07.11  
6: JP 2000-323623 A(三菱電機株式会社)2000.11.24  
7: JP 2003-273317 A(NECエレクトロニクス株式会社)2003.09.26

請求の範囲1-2, 4-6, 8-9, 13, 17に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性を有しない。請求の範囲1-2, 4-6, 8-9, 13, 17に記載された発明は、文献1に開示されている。

請求の範囲1-2, 4-6, 8-9に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献2から新規性を有しない。請求の範囲1-2, 4-6, 8-9に記載された発明は、文献2に開示されている。

請求の範囲1-2, 4, 9に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献3から新規性を有しない。請求の範囲1-2, 4, 9に記載された発明は、文献3に開示されている。

請求の範囲3, 7, 10, 16に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1より進歩性を有しない。搭載基板に端子を二組以上設けることは周知技術である。また、外部接続用端子とテスト用端子の配置は、単なる設計事項である。そして、半導体チップを二つ以上積層することは、普通に行われている。さらに、封止部材により基板の外縁端部を包み込むように形成することは、慣用手段にすぎない。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V 欄の続き

請求の範囲11, 19に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1, 4より進歩性を有しない。スペーサーを配置することは、文献4に記載されている。

請求の範囲12に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1, 5より進歩性を有しない。配線の一部を封止部材の表面に露出させることは、文献5に記載されている。

請求の範囲14-15に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1, 6より進歩性を有しない。外部接続用端子の配置領域に対応する封止部材を相対的に小さな厚みとすることは、文献6に記載されている。また、該領域を外周部とすることは、単なる設計事項にすぎない。

請求の範囲18に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1, 7より進歩性を有しない。主基板に表面に主半導体を配置して、主半導体の表面に半導体パッケージを配置することは、文献7に記載されている。